

Intern-Auftrag an die Leiterplattentechnologie Universität Ulm

A_ _ _ _ .

Stempel Institut / Einrichtung

Auftraggeber: Name, Vorname / EMail / Telefon intern

Institut / Einrichtung: Bezeichnung / Kostenstelle-Projekt / EMail für PDF-Rechg.

Kurzbeschreibung

- Bachelor-, Masterarbeit Forschung
 Lehre, Praktikum Sonstiges

Leiterplattenfertigung

L_ _ _ _ .

Beschreibungen / Anmerkungen / Anlagen

PCB

Menge/Anzahl/Stück

Abmessung [mm] x

Basismaterial FR4 Ro4003

Materialdicke [mm] 0,2 0,4 0,5 0,8 1,0
 1,5 2,5

Durchkontaktiert Nein (NDK) Ja (DK)

Cu-Schicht [µm] 18 (NDK) 30..50 (DK)
 35 (NDK) 40..75 (DK)

Ätzkompensation [µm] Nein Ja

DK-Zuschlag [µm] Nein Ja

Oberflächenfinish Cu-Blank Chem. Silber
 Chem. Gold (ENIG / NiAu)

Anzahl Cu-Lagen 1(SL) 2(DL) 4(ML)

Layer: Für jede ausgewählte Lage eine Gerberdatei

- PMT Lötpastenstencil TOP (extern)
- SST Bestückungsdruck TOP
- SMT Lötstopp TOP
- TOP Cu-Außenlage oben
 - IN1 Cu-Innenlage 1
 - IN2 Cu-Innenlage 2
 - IN3 Cu-Innenlage 3
 - IN4 Cu-Innenlage 4
 - IN5 Cu-Innenlage 5
 - IN6 Cu-Innenlage 6
- BOT Cu-Außenlage unten
- SMB Lötstopp BOT
- SSB Bestückungsdruck BOT
- PMB Lötpastenstencil BOT (extern)
- DIM Boardkonturen

Layer: Für jedes Lagenpaar eine Excellon-Datei

- DRL Bohrdatei(n)
- DRL Bohrdatei(n) VIAs
- DRL Bohrdatei THP plated
- DRL Bohrdatei THN nonplated

Anlagen

- Filme, Maske, Vorlagen >> Anzahl:
- Kontrollplots, Lagenaufbau, Bemaßung

Für interne Vermerke

Auftrag erteilt

Datum

Unterschrift